

## MHS 5/08 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

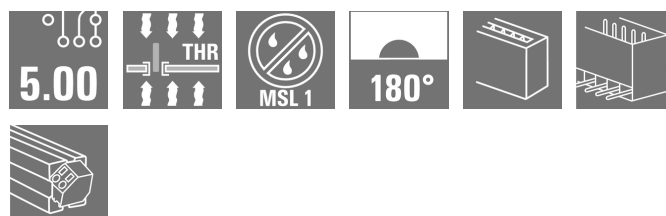
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## OMNIMATE 4.0 – 次の進化の段階

OMNIMATE 4.0 は、One Cable Technology (OCT) の動向に沿うものです。モジュールコンセプトによりデータ、信号、電力を一つのコネクタで伝送するハイブリッド・コネクタを迅速に構成可能です。その結果、さまざまなアプリケーションでケーブル配線の手間を減らし、メンテナンスをシンプルにし、オートメーション・プロセスを加速させることが可能です。独自のSNAP IN接続を採用し、配線作業の高速化を実現しました。

## 史上最速の接続

- 独自のSNAP IN接続により、工具不要で迅速かつ安全な配線を実現
- 開放状態のクランプポイント「wire ready (ワイヤレディ)」納入によるロボット配線に対応
- 視覚的なインジケータとクリック音による安全な配線

## 独自の構成を作成可能

- ワイドミューラーコンフィギュレータ (WMC) を使用した柔軟な構成と発注が可能
- 3 日以内に製造- 個別構成製品も含まれます
- 設定済み製品の自動注文システム

## モジュール式ハイブリッドコネクタのシンプルな構成

- 電力、信号、およびデータ転送の柔軟な組み合わせオプション

- 将来のニーズにも対応できるシングルペアイーサネットテクノロジー

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, THT/THRはんだ接続, ピッチ (mm) (P): 5.00 mm, 極数: 8, 180°, Tube |
| 注文番号       | <a href="#">8000072453</a>  |
| 種別         | MHS 5/08 V T3 B T   |
| GTIN (EAN) | 4064675423126   |
| 数量         | 13 Stück  |
| 製品データ      | IEC: 400 V / 25.3 A<br>UL: 300 V / 18.5 A   |
| パッケージ      | Tube  |

作成日 2024/07/02 5:43:42 CEST

## MHS 5/08 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|            |            |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|
| 深さ         | 11.9 mm    | 奥行き (インチ) | 0.469 inch |
| 高さ         | 17.2 mm    | 高さ (インチ)  | 0.677 inch |
| 下位バージョンの高さ | 14 mm      | 幅         | 41.38 mm   |
| 幅 (インチ)    | 1.629 inch | 正味重量      | 5.221 g    |

## システム仕様

|                             |                 |                           |              |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 製品ファミリー                     | OMNIMATE 4.0    | 接続方式                      | 基板接続         |
| PCB の取り付け                   | THT/THRはんだ接続    | ピッチ (mm) (P)              | 5 mm         |
| ピッチ (インチ) (P)               | 0.197 "         | 外向きエルボ                    | 180°         |
| 極数                          | 8               | 極当たり溶ダーピン数                | 1            |
| 溶ダーピン長 (l)                  | 3.2 mm          | はんだピン寸法                   | 1.0 x 1.0 mm |
| 溶ダーアイレット穴直径 (D)             | 1.4 mm          | 溶ダーアイレット穴直径公差 (D)         | +0.1 mm      |
| はんだパッドの外径                   | 2.3 mm          | テンプレート開口径                 | 2.1 mm       |
| L1 (mm)                     | 35 mm           | L1 (インチ)                  | 1.378 "      |
| 行数                          | 1               | ピンモデルシリーズ数量               | 1            |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | プリント基板の上にタッチセーフ | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20        |
| 保護度合い                       | IP20            | 体積抵抗                      | ≤5 mΩ        |
| プラグング回数                     | ≥ 25            | 差し込み力 / 極、最大              | 8.5 N        |
| 引張強度/極、最大                   | 8.5 N           |                           |              |

## 材料データ

|              |          |                      |        |
|--------------|----------|----------------------|--------|
| 絶縁材          | PA 9T    | 色                    | 黒色     |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁材グループ              | I      |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 600    | Moisture Level (MSL) | 1      |
| UL 94 可燃性等級  | V-0      | 接点ベース素材              | CuMg   |
| 接点材質         | 銅合金      | 接触表面                 | 錫メッキ   |
| 錫メッキの種別      | つや消し     | 保管温度、最小              | -25 °C |
| 保管温度、最大      | 55 °C    | 動作温度、最小              | -50 °C |
| 動作温度、最大      | 100 °C   |                      |        |

## IEC規格に準拠した公称データ

|                             |                        |                             |        |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 標準に準拠して検査済                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C)         | 25.3 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C)         | 20.8 A                 | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C)         | 21.8 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C)         | 18 A                   | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 400 V  |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 320 V                  | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3    | 250 V  |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 4 kV                   | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV   |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV                   | クリアランス、最小                   | 4 mm   |
| 沿面距離、最小                     | 5.4 mm                 |                             |        |

## MHS 5/08 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)



証明書番号 (cURus)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (グループ F / UL 1059 使用) 420 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 18.5 A

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 10 A

クリアランス距離、最小 4 mm

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

沿面距離、最小

5.6 mm

## 分類

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ETIM 8.0

EC002637

ETIM 9.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

ECLASS 12.0

27-46-02-01

ECLASS 13.0

27-46-02-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

## 重要なメモ

IPC準拠

適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。
- 図面上のP = ピッチ
- 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。
- はんだアイレットの直径D = 1.4+0.1mm
- OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません
- 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

## 承認

認可



UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E60693

作成日 2024/07/02 5:43:42 CEST

## MHS 5/08 V T3 B T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf</a><br><a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

# MHS 5/08 V T3 B T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 製品イメージ



### 寸法図



## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.